

竹科與熊本科學園區簽署 MOU 深化臺日合作



Hsinchu Science Park and Kumamoto Science Park Signed MOU,
Deepening Bilateral Cooperation

新竹サイエンスパークがくまもとサイエンスパークと了解覚書に署名 台日提携を深化します

● 文・圖／投資組 翁淑婷



簽署儀式合影，由左至右：科管局胡世民局長、熊本縣木村敬知事、三井不動產細田恭祐代表理事

竹科為推動臺日科技合作及半導體產業國際布局政策，深化與日本九州半導體聚落交流，科管局胡世民局長於 2026 年 7 月 27 日與日本熊本縣木村敬知事及三井不動產細田恭祐代表理事，共同簽署竹科與熊本科學園區合作備忘錄（MOU），正式建立園區合作機制，未來將在半導體、新創育成、人才培育及產業交流等領域深化合作，共同打造臺日科技創新合作平台。

近年全球半導體產業鏈加速重組，日本積極推動半導體產業復興，熊本更因國際半導體大廠投資及相關供應鏈聚集，快速發展成為日本最具代表性的半導體重鎮。竹科與熊本縣及三井不動產近年持續保持密切交流，雙方多次就科學園區發展、半導體產業布局及新創生態等議題交換意見。此次簽署合作備忘錄，不僅象徵雙方建立長期且制度化的合作夥伴關係，更強化臺日共同推動科技創新及提升供應鏈韌性的發展。



簽署儀式後大合照